

日立化成工业(苏州)有限公司

日立(中国)有限公司

2005年12月26日

日立化成工业（苏州）半导体封装材料新厂竣工

日立化成工业株式会社（总部：东京，执行役社长：长濑宁次，注册资金：153亿日元）的子公司——日立化成工业（苏州）有限公司（总部：江苏省苏州市，总经理：佐藤洋三，注册资金：8,276万元人民币）为进一步强化中国市场的半导体材料业务，斥资约2亿元人民币，在苏州工业园区成立年生产能力达6,000吨的半导体封装材料厂，日前该厂已宣告竣工。

过去，大多是以日本和欧美为主的后工序工厂跻身于中国半导体产业，而近年来，随着日本、欧美和韩国等地的一些大型半导体生产厂家相继来华投资，建立许多前后工序一条龙的大规模工厂，而中国国内各大企业也在加速半导体生产。目前，中国的半导体产业正在飞速发展，并且今后对于环保型封装材料的要求也将进一步提高。日立化成工业（苏州）有限公司作为半导体材料生产厂家，积极致力于满足中国市场上这种不断扩大的需求。该公司日前竣工的封装材料厂将以生产逻辑门电路的半导体为中心，生产符合环保要求的高级封装材料。在今后的生产过程中，该工厂还将加紧进行客户认定材料的工作，同时在交货期、技术服务等方面迅速建立起能够满足客户需求的体制。

日立化成集团目前已在日本及马来西亚对用于半导体的封装材料开展了生产工作，当在中国建立起新的生产基地后，将可形成约30,000吨/年的供应体制。该公司计划到2010年时将中国市场份额从目前的约20%（根据该公司的估算）提升至40%以上，从而获得最高的市场占有率，并将以此生产基地为起点，加快今后在华电子原材料事业的发展。

<日立化成工业（苏州）有限公司简介>（截止至2005年11月底）

- 公司名称：日立化成工业（苏州）有限公司
- 所在地：中国江苏省苏州市苏州工业园区兴浦路198号
- 注册资金：8,276万元人民币
- 股东：日立化成工业株式会社（100%）
- 公司代表：总经理 佐藤洋三
- 员工人数：30人（正式投产后约100人）
- 事业内容：半导体封装材料的制造和销售
- 总投资额：约2亿元人民币
- 占地面积：约66,000 m²
- 生产能力：约6,000吨/年
- 正式投产：2006年4月

<日立化成工业株式会社的简介> (截止至 2005 年 9 月底)

公司名称 : 日立化成工业株式会社
所在地 : 日本、东京都新宿区西新宿 2-1-1
注册资金 : 153 亿日元
主要股东 : 株式会社日立制作所 51%
公司代表 : 长濑宁次 (执行役社长)
相关员工人数 : 17,001 人
相关事业内容 : 电子相关产品、性能性材料相关产品、住宅机器和环境设备的制造以及销售
合并销售额 : 5,556 亿日元 (截止至 2005 年 3 月)

=有关详情请咨询=

【技术问题】 日立化成工业 (苏州) 有限公司 技术部 五个 容
地址: 江苏省苏州市苏州工业园区兴浦路 198 号
E-mail: s-goka@hitachi-chem.com.cn
TEL: 0512-6260-1818

【销售问题】 日立化成工业 (上海) 有限公司 营业部 铃木 真
地址: 上海市浦东大道 138 号永华大厦 10 楼 ABC 座
E-mail: m-suzuki@hitachi-chem.com.cn
TEL: 021-5887-1570

【报道问题】 日立 (中国) 有限公司 公共关系部 久保 达哉
地址: 北京市朝阳区东三环北路 5 号北京发展大厦 18 层 100004
E-mail: tkubo@hitachi.cn
TEL: 010-6590-8141 (直拨)

日立 (中国) 有限公司 公共关系部 刘莉
地址: 北京市朝阳区东三环北路 5 号北京发展大厦 18 层 100004
E-mail: lliu@hitachi.cn
TEL: 010-6590-8111-2397

普乐普公共关系顾问有限公司 万熠
地址: 北京市东城区东长安街1号东方广场西1 (W1) 办公楼902室 100738
E-mail: wanyi@prap.com.cn
TEL: 010-8518-5208-60